

## Ingénieur Moyens et Procédés FES Wafer H/F - CDI

Basée à Nozay (91), 3SP Technologies est une PME de 104 salariés qui conçoit et fabrique des diodes lasers de puissance et de transmission et des modules optoélectroniques pour les réseaux optiques de communication et les applications industrielles.

Grâce à sa filière technologique de réalisation de semi-conducteurs AsGa et en InP héritée d'Alcatel-Optronics, notre entreprise a pour mission d'être un partenaire et un fournisseur fiable de rang mondial pour les industries qui utilisent les technologies laser avancées.

Aujourd'hui, nous recherchons un Ingénieur Moyens et Procédés FES Wafer H/F en CDI.

### ROLE PRINCIPAL

*Assure le support technique à la Fabrication sur les procédés et moyens pour les ateliers Wafer.  
Propose et met en œuvre les plans de progrès et d'industrialisation, les nouvelles briques technologiques des produits internes et les procédés pour les demandes externes de sous-traitance.  
Contribue au développement de nouveaux produits et à leur introduction en fabrication.*

### Missions/Tâches

#### **ACTIVITE A: Support à la Fabrication des filières AsGa & InP**

- Assure la mise à jour de la documentation de fabrication : synoptique, plans de contrôle, MO,FP, plans.
- Contribue à la rédaction du plan de formation du personnel.
- Suit les indicateurs liés à des étapes technologiques spécifiques en Wafer.
- Réalise dans ce cadre des analyses de corrélation avec les données puces et CSE.
- Participe en collaboration avec l'IP au maintien de la performance de la Fabrication en ce qui concerne les rendements, la qualité, les engagements de livraison et les coûts de production.
- Travaille en étroite collaboration avec le chef de service Wafer & Bar et assure un soutien technique auprès des opérateurs.
- Intervient sur demande de la Fabrication ou suite à sa propre analyse pour définir les actions correctrices suite à aux problèmes rencontrés sur les procédés ou les moyens de production. Peut lui-même réaliser ces actions correctrices ou assister les opérateurs ou la maintenance dans leur mise en œuvre.
- Définit les conditions de validation des équipements après une opération de maintenance.
- Peut s'adresser au Service Epitaxie pour obtenir une collaboration vis-à-vis d'analyses à mener.

#### **ACTIVITE B: Mise en œuvre des Plans de Progrès**

- Travaille conjointement avec l'Ingénieur Produits à la déclinaison des plans de progrès (recherche de la diminution des coûts et l'augmentation de la productivité au poste).
- Identifie les étapes à améliorer, propose les plans d'amélioration et d'industrialisation des procédés et des équipements associés aux sujets Rendement, Gamme, Matières Premières en se basant sur le suivi de la ligne et des indicateurs associés.
- Réalise ou manage l'exécution de ces plans jusqu'à leur validation dans le cadre de CLM.
- Définit et gère la réalisation des outillages ou des investissements associés.
- Rédige la documentation associée et la formation.

#### **ACTIVITE C: Mise en œuvre des nouvelles briques technologiques**

Cela concerne les produits internes pour lesquels on réalise une adaptation pour répondre à certaines spécifications produits ou besoins industriels (ex : Rmin spécifique, traitement en 3 pouces)

- Analyse le besoin, propose des solutions techniques et leur plan de validation.

- Met en œuvre le plan de réalisation et s'assure de la validation finale.
- Etablit un reporting d'avancement et gère l'introduction des nouvelles briques dans le cadre de CLM.
- Rédige la documentation associée.
- Peut prendre en charge l'introduction et la validation d'une nouvelle brique en tant que Chef de projet.

## **ACTIVITE D: Définition et mise en œuvre des procédés pour le Front-End Services**

Cela concerne l'activité de sous-traitance de Wafer, Bar voire jusqu'à la puce pour un client externe. Dans ce cadre, l'Ingénieur Moyens et Procédés travaille avec le Product Line Manager et L'Ingénieur Produits FES Charges Externes.

- Assure le suivi technique avec le client.
- Analyse le cahier des charges technique et établit en regard le procédé de réalisation en utilisant en priorité nos building-blocks ou en les adaptant.
- Prend en charge les étapes de fabrication et de caractérisation des premiers produits fabriqués si besoin.

## **ACTIVITE E: Contribution au développement et à l'introduction des nouveaux produits**

- Dans le cadre d'un management fonctionnel par la Direction R&D, analyse les besoins et propose des solutions techniques en priorité basées sur nos building-blocks ou compatibles avec ceux-ci.
- Assure la réalisation des plans de développement Wafer sur les nouveaux composants conformément au PLC.
- Assure l'introduction en fabrication des étapes technologiques associées aux nouveaux produits.

## **Moyens / Ressources**

Le poste est défini au sein du Service Ingénierie Front-End et Produits FES. Il n'a pas de ressource dédiée. C'est un poste transverse principalement avec les ateliers de production. Responsable du budget des investissements d'équipements dont il a la charge.

## **Interface clé**

- Interne : Direction de la Production, Ateliers de Production, Qualité, Fiabilité, R&D, le service informatique, Maintenance, PLM (charges externes)
- Externe : Fournisseurs, Clients lors des audits

## **Caractéristique principale de la contribution**

- Contributeur individuelle en forte relation avec les ateliers de production.
- Expert des procédés et des moyens de fabrication des wafers et des bars de composants à base de GaAs et d'InP. Bonne compréhension des procédés épitaxie, puce et CSE.
- Autonome pour mener à bien les actions correctrices et les plans d'amélioration

## **Spécificités**

- Maîtrise de l'anglais.
- Travail en salle blanche.
- Travail sur équipements classés.

## Profil des candidats

### Compétences techniques

- Formation initiale : Ingénieur matériaux spécialité technologie des semi-conducteurs.
- Expérience professionnelle : 3 ans dans un poste équivalent suivant profil et formation.
- Connaissances et niveau : Ingénieur (Physique du solide, composant optoélectronique, technique du vide, PLASMA dépôt ou gravure, photolithographie).
- Anglais requis.

### Compétences personnelles/comportement

- Aptitude au travail en équipe
- Respect des engagements
- Proactif et flexible
- Rigoureux
- Autonomie

Poste à pourvoir dès que possible.

Si cette offre vous intéresse, nous vous invitons à transmettre votre candidature à l'adresse suivante :  
**rh@3spgroup.com**